

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

## 苏州固锔电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01-05

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	天风证券              刘思贝 天风证券              张钰莹 鑫元基金              葛天伟 鹤禧投资              吴迪 鹤禧投资              司岩 歌斐资产              姚淳耀 常春藤资产              程熙云 常春藤资产              陈健 龙航资产              李方勇 宁泉资产              陈冠群 宁泉资产              李商羽 敦和资产              张铎
<b>时间</b>	2022年01月05日 PM14:00--15:30
<b>地点</b>	苏州固锔电子股份有限公司华金路200号三楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	苏州固锔电子股份有限公司董事会秘书      杨朔
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	本次会议的主要内容是对苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”）及全资子公司苏州晶银新材料科技有限

公司（以下简称“苏州晶银”）整体经营情况的介绍，具体内容如下：

1、请简单介绍一下苏州晶银的整体经营情况：

苏州晶银新材料科技有限公司成立于2011年8月10日，注册资本9318.1716万元人民币，是苏州固得全资子公司。2021年第三季度，苏州晶银新厂房的6个研发平台陆续投入使用，同时，苏州晶银大量引进相关研发人才，开展其他领域浆料研发。在光伏银浆方面，苏州晶银加强了TOPCON浆料的研发力量，TOPCON浆料性能得到了提高，在数家客户测试中取得了良好的结果；同时 HJT纯银浆料在效率、耗量和印刷性能上较之前也取得了显著进步；银包铜浆料也有改善，新开发出银包铜主栅浆料，突破了银包铜浆料附着力和焊接的问题。2021年1-9月份，苏州晶银异质结浆料销售量共计3.73吨。

2、苏州晶银的银包铜粉是自己研发还是外购？

银包铜粉是外购的，苏州晶银不生产银粉。

3、苏州晶银目前高温银浆产品中银粉使用的是国产还是进口银粉？

苏州晶银主要使用的是国产银粉。2018年及2019年，国产银粉占苏州晶银当年度银粉采购总额的95.82%和92.17%。

4、苏州晶银银包铜产品目前进度如何？

公司2021年上半年就已经顺利推出银包铜HJT低温浆料，在客户处得到较高评价，目前在可靠性测试验证中。

5、TOPCON浆料与PERC的差异？

TOPCON浆料分正面和背面，背面银浆与目前的PERC正银类似，正面银浆中有铝的成分，属于银铝浆。目前，TOPCON银浆已有少量出货。

6、HJT产能如何？与高温银浆的区别主要在哪方面？

银浆的设备大部分是通用的，HJT与高温银浆的核心区别主要在配方上。

	<p>7、2021 年半导体部分增速快的主要原因是什么？</p> <p>2021 年，公司半导体业务增长较快，一方面是 2021 年半导体行业整体景气度高，功率半导体国产替代加速，公司半导体产品产销两旺；同时，公司扩产的产能逐步释放，公司在前几年战略部署的汽车电子产品市场占有率不断提升，集成电路和 PPAK 封装、MEMS 封测均增长较快，销售额和销售量创历史新高。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，也未向投资者提供任何书面资料，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-01-05